

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻中国证监会《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“《科创板八条》”）指导精神，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，推动公司高质量发展，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

本行动方案已于 2024 年 7 月 15 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将行动方案具体举措公告如下：

一、聚焦经营主业，深耕集成电路先进封装测试

公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

随着中国大陆显示面板产业和集成电路产业的快速发展，显示驱动芯片产业制造和封测环节出现了明显的由中国台湾向中国大陆转移的趋势。另外，智能手机、高清电视、车载显示等消费电子领域越来越多的中高端屏幕采用

AMOLED 新型显示技术替代 LCD。AMOLED 具有能耗低、发光率好、亮度高和轻薄等优点，在终端设备中的应用越来越广泛。受益于产业转移和 AMOLED 显示屏市场渗透率快速提升，近年来显示驱动芯片封装测试需求在集成电路下行周期当中仍保持着相对稳定的增长。2023 年度，公司实现营业收入 12.38 亿元，同比增长 31.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.68 亿元，同比增长 33.30%，经营业绩持续向好。

2024 年，公司将聚焦核心优势，不断深耕集成电路先进封装测试业务，拓展封测芯片的品类，在新型显示、车载芯片等更多细分应用领域进行研发投入；同时，公司基于领先的凸块制造及倒装封装技术，不断拓宽技术边界。具体包括以下几个方面：

1、推进可转债募资，扩充高阶测试产能，优化产品结构

2023 年，公司首发募集资金已使用完毕，随着市场景气度修复，公司产能利用率持续攀升，高阶测试平台产能趋于饱和，存在进一步扩充产能的需求。同时，公司为扩大在 AMOLED、Micro OLED 等新型显示领域的产能配置，满足新型显示驱动芯片快速增长的市场需求，进一步提升公司在显示驱动芯片领域的竞争优势，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 114,870.00 万元，主要用于加码新型显示驱动芯片封测业务，推进 12 吋先进制程新型显示驱动芯片封装测试产能扩充。可转债预案经董事会审议通过后，公司已以自有或自筹资金先行投入可转债募投项目。可转债募投项目的实施，有助于继续提升公司高阶测试平台产能，扩大新型显示领域的产能配置，进一步优化产品结构，增强主营业务盈利能力。

2、以客户需求为导向，积极拓展市场份额，拓宽技术应用边界

公司拟在合肥市新站区合肥综合保税区内投资建设汇成二期项目，第一阶段总投资约 10 亿元，主要用于扩充先进封装测试产能，并依托现有技术延伸产线工艺至车载芯片封装测试等更多细分领域。

公司始终坚持以客户需求为导向，基于产业转移的时代背景，积极响应客户新产品研发需求，助力客户完成新产品验证及量产导入；持续加深与细分领

域头部客户的合作关系，积极开拓中国大陆地区具备成长潜力的优质客户资源，并基于客户需求延伸先进封装制程，拓宽封测业务下游应用领域，持续增强公司核心竞争力。

3、提升精细化管理水平，增强公司核心竞争力

集成电路封装测试行业对于运营管理的精细化水平要求较高，只有不断强化内部管理、提升经营效率，才能保障持续盈利能力。2024 年，公司将继续坚持推动产线信息化、自动化建设，借助“数智赋能”打造智能工厂；不断优化质量管理体系和质量管控模式，加大力度开展员工技能培训，防范作业异常，稳定产品品质；同时不断提升精细化管理水平，加强内部生产管理与资源整合，通过工艺优化、分线管理等手段提升生产效率，降低生产成本，实现提质降本增效，提升公司核心竞争力。

4、外延发展，布局产业链生态集群

为充分贯彻《科创板八条》指导精神，在自身不断夯实主营业务的同时，公司将探索通过并购整合适合的标的，从技术互补或市场扩张等方面来提升上市公司的综合竞争力，在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，公司将继续积极审慎评估与主营业务相关的合作机会，通过外延式增长等方式拓宽先进封装技术应用边界，拓展更多细分市场品类。公司将潜在并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和未来收益，确保并购交易符合公司发展战略。同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，确认实施过程中真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保障广大投资者知情权。

二、保障技术工艺研发投入，培育新质生产力

公司高度重视技术创新和工艺研发，为了保持产品和服务的技术领先水平 and 市场竞争优势，公司持续增加研发投入。2023 年研发投入 7,885.72 万元，占当年营业收入比例为 6.37%；2019 年至 2023 年五年间研发投入的复合年均增长率为 14.78%。

2024 年，公司将保持必要强度的研发投入，在保障凸块制造等现有核心技术持续领先的同时，不断拓宽技术边界，基于客户需求积极布局 Fan-out、

2.5D/3D、SiP、HBM 等高端先进封装技术。针对公司现有核心技术不断加强工艺研发，深挖先进封装护城河，保障制造稳定性，减少生产异常，提高产品良率，降低生产成本。针对横向和纵向技术边界拓展，公司将瞄准高端先进封装发展方向做好基础技术研发，保证研发投入和人才储备，以期突破集成电路行业技术瓶颈培育新质生产力。

三、完善内控建设，强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

1、完善内部控制体系建设

2022 年 8 月上市以来，公司严格按照法律法规的要求，对标优秀上市公司，不断健全法人治理结构和完善内部控制体系，持续强化“三会一层”建设。公司股东大会、董事会、监事会与管理层权责清晰、运行有效，已形成体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

随着《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、业务规则不断更新完善，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司相应地对内部控制相关管理制度进行修订，保障内部控制制度的完善性和有效性，进一步优化公司内部控制体系，确保股东能够充分行使权利，确保董事会及各专门委员会、监事会、独立董事及管理层能够认真履职。

2、发挥独立董事关键作用

独立董事制度改革是国务院推动资本市场重要改革之一，2024 年公司将严格落实独立董事制度改革，组织公司董监高等“关键少数”加强独立董事新规学习，配套《上市公司独立董事管理办法》修订公司章程和相关治理制度文件，为独立董事履职提供支撑保障，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。公司董事会办公室作为与独立董事对接的直接沟通部门，将及时向独立董事汇报公司经营及其他重大事项，组织筹备独立董事专门会议，为独立董事开展工作提供应有的便利，保障独立董事的知情权和特别职权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。此外公司 2024 年在董事会换届工作当中严格落实独立董事

制度改革，切实提升董事会治理效能，改善决策效率和运作效果，提高公司发展质量。

3、增强“关键少数”合规意识，加强共担共享约束

2024年，公司将持续督促实际控制人、董监高等“关键少数”积极参与证监会、上交所、证监局等监管机构举办的各类培训，并持续加强“关键少数”的内部培训，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律法规，理解监管动态，强化公司“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展与持续规范运作。本年度，公司将安排董监高参与不少于5次（10课时）的上述培训活动。

公司建立了实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，公司实际控制人之一郑瑞俊先生担任公司董事长、总经理，公司主要高级管理人员通过股权激励计划持有公司股份。2023年，公司已推出第二类限制性股票激励计划，公司激励计划的考核指标设定具有科学性和合理性，对激励对象具有约束性，有利于充分保障公司股东的利益，有助于强化管理层与股东利益共担共享。2024年，公司将持续优化高管薪酬方案，高管薪酬方案系结合行业整体薪酬水平及地方薪资标准等因素确定，由基础薪酬与年度绩效两部分构成，年度绩效部分与公司经营业绩高度相关，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后发放，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

随着管理层与股东的利益共担共享机制的进一步强化，“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当将进一步增强，有助于充分发挥“关键少数”在公司经营决策当中的作用，推动公司的长期稳健发展。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

1、严格落实信息披露工作，提高信息披露质量

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，合规履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024年，公司将持续加强信息披露管理工作，切实提高定期报告和临时公告的披露质量，及时、合规地公开披露投资者关切的经营情况和重大事项，以

期在上市公司信息披露工作评价当中取得更好的评价结果和等级，牢固树立良好的资本市场形象。

2、构建多层次投资者沟通渠道，提振投资者信心

公司建立了较为规范的投资者关系工作体系，设立了投资者关系专用邮箱和投资者沟通热线，同时适时召开投资者说明会、分析师会议和特定对象调研活动，向市场合规传递公司经营动态和内在价值。2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，为股东提供准确的投资决策依据，不断完善投资者意见传递渠道，详细了解投资者的真实诉求，并通过各种渠道有针对性地回应，不断提升公司信息披露质量，树立市场信心。具体措施如下：

(1) 定期召开业绩说明会：2024年公司计划召开不少于3次公开业绩说明会，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，公司主要高管将出席业绩说明会，通过电话、视频、文字回复等多种方式积极与投资者交流互动，就公司经营情况、发展规划等进行沟通，保障各类投资者公平、平等获取公司信息。

(2) 持续开展投资者交流活动：2024年公司计划组织不少于3次“投资者开放日”活动，邀请投资者到公司实地进行面对面交流；公司将常态化接待投资者调研活动，开展不少于30次包括线上电话会议或线下面对面的投资者接待活动，增进公司在市场当中的认知度。

(3) 完善投资者沟通及意见反馈机制：公司将日常保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问，对广大投资者关心的问题进行了解和答复，并将投资者意见及时整理、反馈，切实加强投资者的沟通与互动，提高公司信息披露的质量和透明度。

五、提升公司投资价值，与股东共享公司发展成果

1、重视投资者回报，现金分红保障股东共享公司发展成果

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。公司牢固树立回报股东的意识，坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，重视投资者回报。

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》和《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定了合理的分红方案。2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利82,440,627.70元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.06%。

2024年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。公司将制定更为积极的现金分红方案，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展。在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，坚持以现金分红为导向，研究提高年度分红频次的可行性。

2、积极推动股份回购，应用多种市值维护举措

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值合理回归，公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生2023年12月10日提议公司使用5,000万元（含）至10,000万元（含）回购公司股份，经公司董事会审议批准，公司于2023年12月23日公告了股份回购方案。截至2024年6月30日，公司已累计回购股份1,111.90万股，占公司总股本的比例约为1.33%，已支付的总金额为9,345.52万元（不含交易费用）。

2024年，公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况实施稳定股价预案。在必要的情况下，适时积极采取股份回购注销、实际控制人或董监高增持等多种措施，提振市场信心，引导公司市场价值向内在价值理性回归，助力企业良性发展。公司将与广大投资者一道，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

六、总结

上述“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的规划，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化、行业变化及公司经营状况

变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年7月17日